

# 出展のご案内

## センシング・半導体後工程で 次の未来を創る

未来社会を創造する  
センシングテクノロジー

Smart Sensing  
2026

半導体後工程/  
パッケージング技術



SEMISOL 2026  
半導体後工程技術&ソリューション展

2026.6.10Wed. ~ 12Fri. 10:00 ~ 17:00  
東京ビッグサイト 西3ホール

先端技術が連携する、次のビジネスに発展する、  
そして参加者同士がボーダレスにつながる展示会へ

センサ  
センシング技術  
IoT

Exhibition

- 新製品・技術の発表
- デモ展示、技術相談
- 製品仕様の紹介
- 試作品展示
- サンプル提供 など

半導体後工程技術  
パッケージング  
製造プロセス装置

4つの企画 /

Co-Creation  
Booths

体験展示

AI  
ソフトウェア  
データ活用

セミナー

Innovators'  
Net Working

センサからAI、データ活用サービスまで、未来の可能性を広げる技術がここに集結し、製造業の課題解決を加速させます。最先端の電子デバイスやセンシング技術を通じて、皆様の製品・技術の発信、ビジネスパートナーの開拓やマーケティングの場としてもご利用いただけます。

## 出展対象

### センサ・センシング技術、AI、データ活用サービス

- 各種センサ・センサノード  
環境、光、温度、彩度、加速度、ジャイロ、慣性力、圧力、磁界、化学、人感、におい など
- センシングデバイス
- AIセンサ/AIソフトウェア **NEW**
- エッジコンピューティング/エッジAIソリューション **NEW**  
センサ・IoTデバイスからのデータを高速処理し、低遅延・高信頼を実現するような技術・ソリューション など
- データプラットフォームサービス
- 電源技術、システム  
エネルギーハーベスティング・フレキシブル、自立電源など
- 通信デバイス・ネットワークシステム  
Bluetooth Beacon, Zigbee, Wi-SUN, LPWA, Wi-Fi, 6G/5G, LTE など
- マシンビジョンソリューション、ソフトウェア
- 大学・研究機関 など

## 来場対象

### センサ、センシング技術を求める研究者、製品開発、設計技術者

- 設計、生産、製品開発部門の責任者、担当者、設計技術者
- センサ等の購買、調達部門の責任者、担当者
- センサ技術、センシングソリューション、サービスを導入したいエンドユーザー  
インフラ、建設、サービス、流通、エネルギー、医療 など
- デジタルプラットフォーム
- あらゆる産業のDX推進担当者
- 大学研究室、研究機関の研究者
- 商社、コンサルタント
- マーケティング部門の担当者 など



## 出展対象、来場対象

次世代の半導体市場を支える後工程・パッケージング技術・ソリューションに特化した展示会です。

半導体技術を求める企業だけではなく、次世代のAI・5G・IoT・車載アプリケーションを見据えたプロフェッショナルに向け、ビジネスマッチングの場を提供します。

## 出展対象

### 半導体後工程に関する材料、素材、部品、製造装置技術

- 半導体後工程製造技術  
チップレット(2.5次元/3次元パッケージ)、ヘテロジニアス接合などの先端パッケージ技術、TSV(シリコン貫通配線)、RDL(再配線層)などの実装技術など、半導体後工程の製造技術全般
- パッケージング関連材料・部品  
材料(封止材、レジストなど)  
パッケージ基板(プリント基板、テープ基板、セラミック基板など)
- 後工程製造プロセス装置・部品・サービス  
グラインディング(研削)、ダイシング(切断)、ダイボンディング(チップ接合)、ワイヤーボンディング(配線接合)、モールドイング(封止)など後工程における装置・材料・製品・関連サービス
- 検査装置・評価・分析ソリューション  
半導体パッケージ検査装置、品質評価、信頼性解析、故障解析などの評価・分析ソリューションなど
- 大学・研究機関

## 来場対象

### 半導体技術を求める専門家、技術者

- 半導体製造工程に携わる技術者、マシンオペレーター
- 半導体に関する装置、製造技術、材料、部材等を導入したい購買、調達部門の責任者、担当者
- 半導体の組立、検査・検品、運搬・出荷作業に携わる担当者
- 半導体関連の大学研究室、研究機関の研究者
- 半導体パッケージング、基板実装分野の専門家
- 半導体業界の経営者
- 半導体製造装置メーカー
- 応用分野に携わる技術者  
電子機器、自動車、ロボット、産業機械、医療機器、航空宇宙、電力 など

## 出展要項

### ▼出展料

出展種別	早期割引/通常	期間	出展料(税込)
スペースのみ(9m <sup>2</sup> )出展	早期割引	2026年1月31日まで	¥396,880
	通常料金	2026年2月1日以降	¥496,100
スペースのみ(9m <sup>2</sup> )出展 独法/大学/ベンチャー	早期割引	2026年1月31日まで	¥237,600
	通常料金	2026年2月1日以降	¥286,000
付帯備品付き(4m <sup>2</sup> )出展	通常料金	全期間適用	¥242,000

### ▼小間仕様

9m<sup>2</sup>出展:スペース渡し(9m<sup>2</sup>:間口3m×奥行3m)  
隣接する小間がある場合には事務局側で仕切りパネル(高さ2.7m)を設置いたします。  
ただし、角小間に設置された場合は通路側のパネルはつきません。  
小間設営・装飾費、電気・給排水・回線料金、小間内清掃・廃棄物処理等工事費および使用料は含まれておりません。

### ▼出展小間位置について

小間位置は主催者が決定いたします。

公式ウェブサイト

